Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Declaration and Power of Attorney for Patent Application

(特許出願宣言書及び委任状)

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

私は、以下に記名された発明者として、ここに下記の通り宣言する:

As a below named inventor, I hereby declare that:

萩本 和徳

Kazunori HAGIMOTO

私の住所、郵便の宛先そして国籍は、私の氏名の後に記載された通りであ My residence, post office address and citizenship る。

are as stated next to may name.

379-0196 日本国群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内

c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Isobe R&D Center, 13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196 Japan

下記の名称の発明について、特許請求範囲に記載され、且つ特許が求めら れている発明主題に関して、私は、最初、最先且つ唯一の発明者である。(唯 一の氏名が記載されている場合)か、或いは最初、最先且つ共同発明者であ る(複数の氏名が記載されている場合)と信じている。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

発光素子及びその製造方法、及び 半導体素子用オーミック電極構造 LIGHT-EMITTING DEVICE, METHOD OF FABRICATING THE SAME, AND OHMIC ELECTRODE STRUCTURE FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

上記発明σ	明細書はここに添付されているが、	下記の欄がチェックされて
いる場合は、	この限りではない:	

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

の日に出願され、			
この出願の米国出願番号または PCT 国際出願番号は、			
であり、且つ			
の日に補正された出願(該当する場合)			

□ was filed on as United States Application Number or PCT international Application Number and was amended on (if applicable).

私は、上記の補正書によって補正された、特許請求範囲を含む上記明細書 を検討し、且つ内容を理解していることをここに表明する。

I hereby state that I have reviewed and understand contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編規則1.56に定義されている、特許性につ I acknowledge the duty to disclose information いて重要な情報を開示する義務があることを認める。

which is material to patentability as defined in Title 37. Code of Federal Regulations, Section

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the need of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to Chief Information Officer, U.S.Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, DC 20231.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、ここに、以下に記載した外国での特許出願または発明者証の出願、或 いは米国以外の少なくとも一国を指定している米国法典第35編第365条 (a) によるPCT国際出願について、同第119条(a)・(d) 項又は第3 65条(b)項に基づいて優先権を主張するとともに、優先権を主張する本出 願の出願日よりも前の出願日を有する外国での特許出願または発明者証の出 願、或いはPCT国際出願については、いかなる出願も、下記の枠内をチェッ

クすることにより示した。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application for which priority is claimed.

Priority Not Claimed 優先権主張なし

Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願

2002-345645	JAPAN	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	
2002-375211	JAPAN	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	
2003-023379	JAPAN	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	
2003-023432	JAPAN	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	
2003-025147	JAPAN	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	
2003-025094	JAPAN	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	
2003-307049	JAPAN	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	
私は、ここに、下記のいかなる米国仮特許出願についても、その米国法典第3		

ここに、下記のいかなる米国仮特許出願についても、その米国法典第3 5編119条(e)項の利益を主張する。

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date) (出願日)

私は、ここに、下記のいかなる米国出願についても、その米国法典第35編 第120条に基づく利益を主張し、又米国を指定するいかなるPCT国際出願 についても、その同第365条 (c) に基づく利益を主張する。また、本出願 の各特許請求の範囲の主題が、米国法典第35編第112条第1段に規定され た態様で、先行する米国出願又はPCT国際出願に開示されていない場合にお いては、その先行出願の出願日と本国内出願日またはPCT国際出願日との間 の期間中に入手された情報で、連邦規則法典第37編規則1.56に定義された特許性に関わる重要な情報について開示義務があることを承認する。

(Application No.)

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date) (出願日)

(Filing Date) (出願日)

私は、ここに表明された私自身の知識に関わる陳述が真実であり、且つ情報 と信ずることに基づく陳述が、真実であると信じられることを宜言し、さらに、 故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国法典第18編第1001条に基づ き、罰金または拘禁、若しくはその両方により処罰され、またそのような故意 による虚偽の陳述は、本出願またはそれに対して発行されるいかなる特許も、 その有効性に問題が生ずることを理解した上で陳述が行われたことを、ここに 官君する。

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可、係属中、放棄)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true: and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued

(Day/Month/Year Filed)	
(出願日/月/年)	
25/12/2002	
(Day/Month/Year Filed)	
(出願日/月/年)	
31/01/2003	
(Day/Month/Year Filed)	
(出願日/月/年)	
31/01/2003	
(Day/Month/Year Filed)	
(出願日/月/年)	
31/01/2003	
(Day/Month/Year Filed)	
(出願日/月/年)	
31/01/2003	
(Day/Month/Year Filed)	
(出願日/月/年)	
29/08/2003	
(Day/Month/Year Filed)	
(出願日/月/年)	

28/11/2002

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.) (出顯番号)

(Filing Date) (出願日) I hereby claim the benefit under Title 35, United States

Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(C) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided

by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

PTO/SB/106(5-00)

Approved for use through 10/31/02. OMB 0651-0032

Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Japanese Language Declaration (日本語宣誓書)

委任状: 私は本出願を審査する手続を行い、且つ米国特許商標庁との全ての業務を遂行するために、記名された発明者として、下記の弁護士及び/または弁理士を任命する。(氏名及び登録番号を記載すること)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and trademark Office connected therewith (list name and registration number)

Ronald R. Snider - 24,962; Elizabeth J. Pawlak - 34,520

書類送付先	Send Correspondence to:
	Ronald R. Snider PO Box 27613 Washington, DC 20038-7613
直通電話連絡先:(氏名及び電話番号) ・	Direct Telephone Calls to: (name and telephone number) Ronald R. Snider
唯一または第一発明者氏名 萩本 和徳	Ronald R. Snider 202-347-2600 Full Name of sole or first inventor Kazunori HAGIMOTO

唯一または第一発明者氏名 萩本 和徳	Full Name of sole or first inventor Kazunori HAGIMOTO
発明者の署名 日付	Inventor's signature Date **Lagunori Hagimete Nov. 10. 2003
住所 379-0196 日本国群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内	Residence c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Isobe R&D Center, 13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196 Japan
日本国	Citizenship JAPANESE
私書箱 379-0196 日本国群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内	Post Office Address c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Isobe R&D Center, 13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196 Japan
第二共同発明者がいる場合、その氏名 能登 宣彦	Full Name of second inventor Nobuhiko NOTO
第二共同発明者の署名 日付	Moluliko Noto Nov. 10. 2003
住所 379-0196 日本国群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内	Residence c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Isobe R&D Center, 13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196 Japan
国籍 日本国	Citizenship JAPANESE
私書箱 379-0196 日本国群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内	Post Office Address c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Isobe R&D Center, 13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196 Japan

(第三以下の共同発明者についても同様に記載し、署名をする (Supply similar information and signature for third and subsequent joint Inventors.)